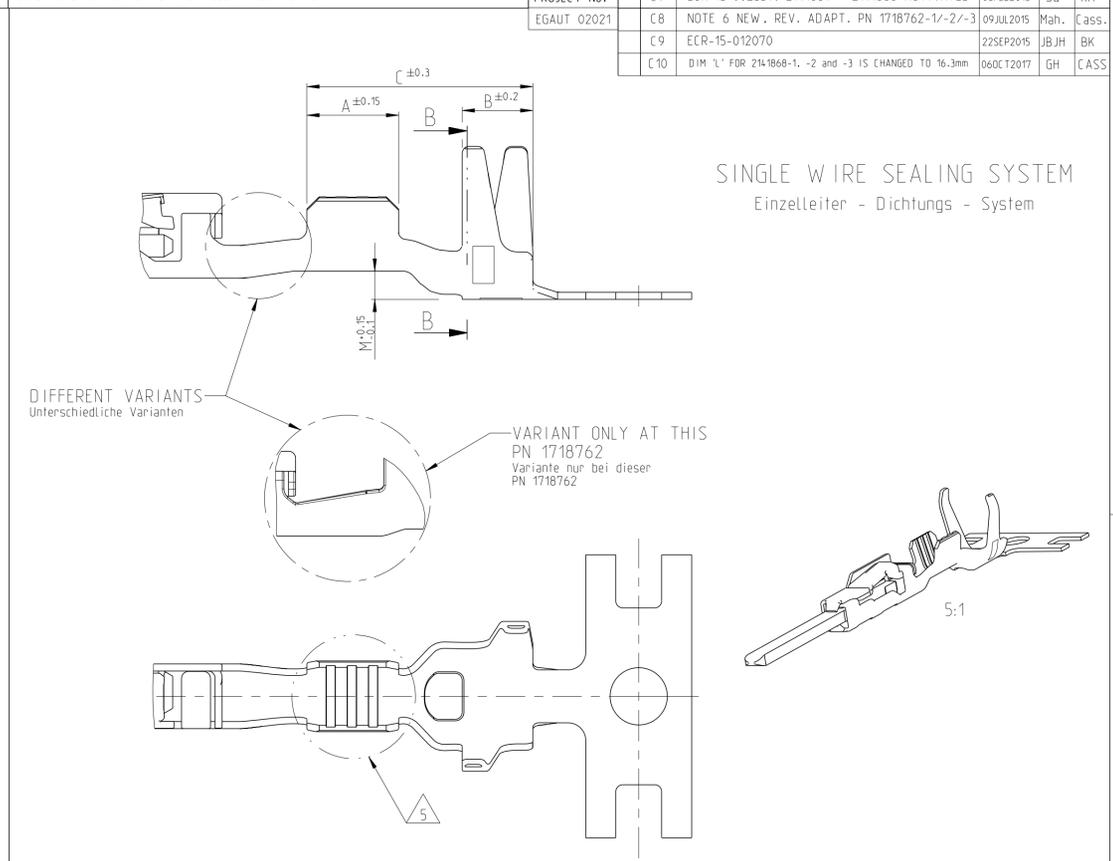
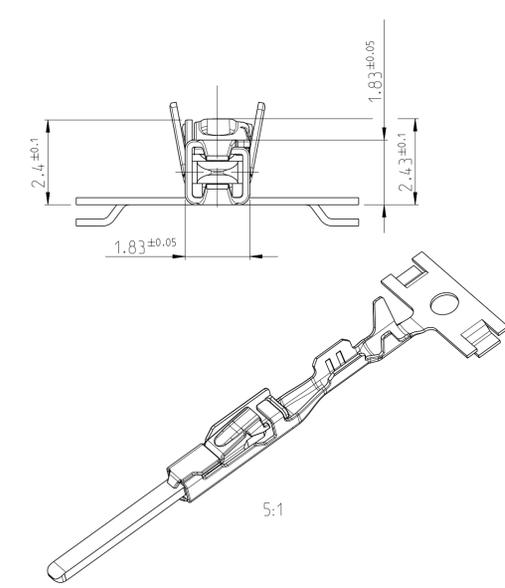
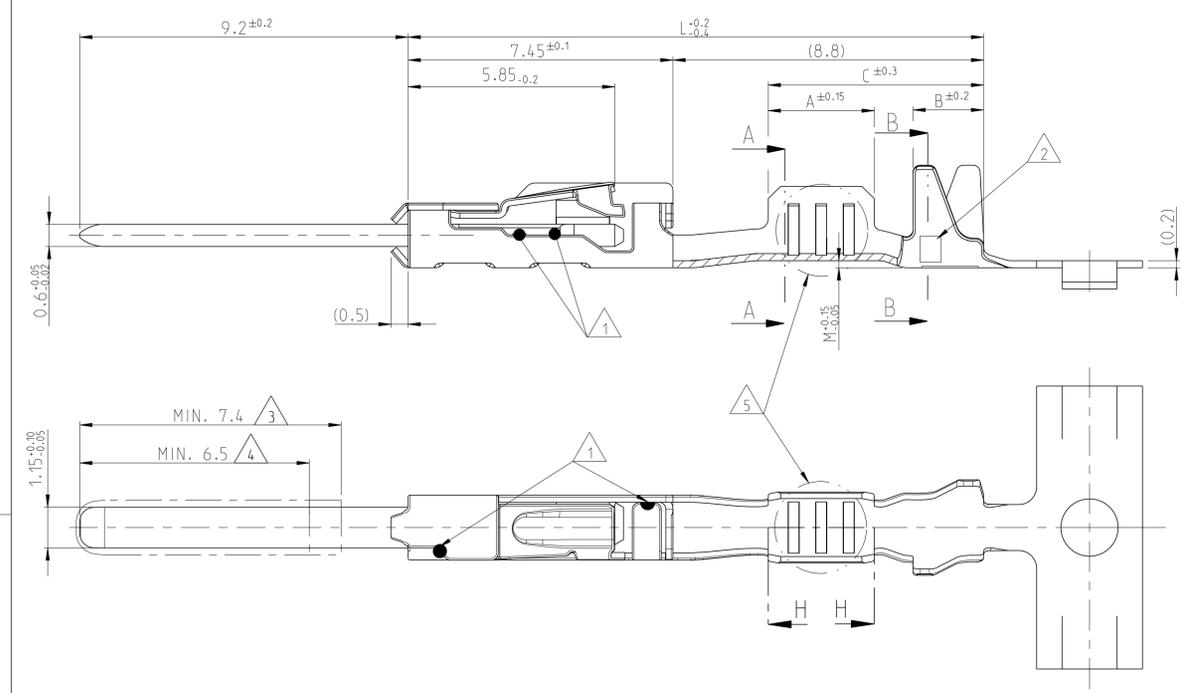


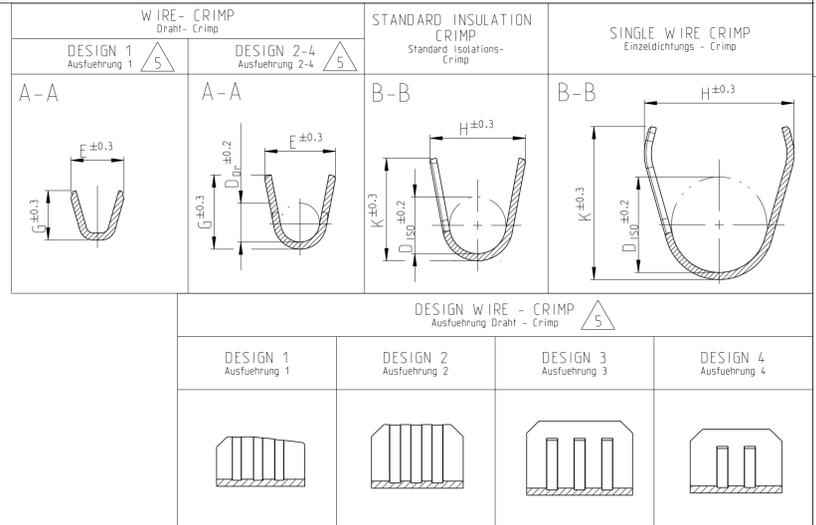
THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONAL IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (Z.B. BIEGESCHLAPTES KABEL) KÖNNEN DIE DELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN, SOFERN DIE FUNKTIONALITÄT NICHT BEEINTRÄCHTIGT IST.

REVOLUTIONS		DATE	OWN	APVD
PROJECT No.	C7	ECR-13-002334, 2141864 + 2141868 ACTIVATED	06FEB2013	SG RM
EGAUT Q2021	C8	NOTE 6 NEW, REV. ADAPT. PN 1718762-1/-2/-3	09JUL2015	Mth. Cass.
	C9	ECR-15-012070	22SEP2015	JBH BK
	C10	DIM 'L' FOR 2141868-1, -2 and -3 IS CHANGED TO 16.3mm	06OC12017	GH CASS



INSULATION CRIMP FOR ISOLATIONSPRIMIERUNG	ORDER NO. Bestell-Nr. STRIP Bandware	REV	WIRE RANGE Drahtgrößenbereich (mm²)	INSULATION ISOLATIONS-Ø (mm)	BODY CONTACTKÖRPER	TAB FLACHSTECKER	BODY CONTACTKÖRPER	SPRING CONTACTFEDER	DESIGN WIRE-CRIMP Ausführung Draht - Crimp	LENGTH Laenge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp	DIMENSION MASS 'L' (mm)	MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberflaeche		
														CU Ni Si	CU Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	CONTACT AREA TAB	
SINGLE WIRE SEALING SYSTEM / Einzeldichtungssystem SEE APPLICATION SPECIFICATION / siehe Verarbeitungsspezifikation	1718762-3	B	1.0 - 1.5	1.9 - 2.4	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	2	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.8	E = 2.6 G = 2.9 D <sub>br</sub> = 1.35	H = 4.4 K = 4.3 D <sub>150</sub> = 2.9 M = 0.8	16.8	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	2	
	1718762-2	C																
	1718762-1	B																
	FLR CABLE / Leitung SEE APPLICATION SPECIFICATION / siehe Verarbeitungsspezifikation	1718760-3	A	0.5 - 0.75	1.4 - 1.9	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	2	A = 2.6 B = 2.0 C = 6.4	E = 2.0 G = 2.1 D <sub>br</sub> = 1.1	H = 4.2 K = 4.3 D <sub>150</sub> = 2.7 M = 0.8	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	2
		1718760-2	B															
		1718760-1	A															
		1718758-3	A	0.25 - 0.35	1.1 - 1.75	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	2	A = 2.6 B = 2.0 C = 6.4	E = 1.8 G = 1.8 D <sub>br</sub> = 0.8	H = 4.2 K = 4.3 D <sub>150</sub> = 2.6 M = 0.8	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	2
		1718758-2	B															
		1718758-1	A															
	2141868-3	A	0.13 - 0.22	2.6	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	1	A = 2.5 B = 1.9 C = 6.2	E = 1.5 G = 1.4	H = 4.0 K = 4.1 D <sub>150</sub> = 2.6 M = 0.6	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	1	
	2141868-2	A																
	2141868-1	A																
INSULATION CRIMP FOR ISOLATIONSPRIMIERUNG	1418762-3	A	1.0 - 1.5	1.9 - 2.4	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	3	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.6 G = 2.9 D <sub>br</sub> = 1.35	H = 3.7 K = 3.9 D <sub>150</sub> = 2.1 M = 0.2	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	3	
	1418762-2	B																
	1418762-1	A																
	5-1418760-3	A	0.5 - 0.75	1.4 - 1.9	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	2	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.0 G = 2.1 D <sub>br</sub> = 1.1	H = 2.7 K = 2.9 D <sub>150</sub> = 1.6 M = 0.2	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	2	
	5-1418760-2	A																
	5-1418760-1	A																
	1418760-3	B	0.5 - 0.75	1.4 - 1.9	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	3	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.0 G = 2.1 D <sub>br</sub> = 1.1	H = 2.7 K = 2.9 D <sub>150</sub> = 1.6 M = 0.2	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	3	
	1418760-2	C																
	1418760-1	B																
	5-1418758-3	A	0.25 - 0.35	1.1 - 1.75	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	2	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D <sub>br</sub> = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D <sub>150</sub> = 1.4 M = 0.2	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	2	
	5-1418758-2	B																
	5-1418758-1	A																
1418758-3	A	0.25 - 0.35	1.1 - 1.75	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	4	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D <sub>br</sub> = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D <sub>150</sub> = 1.4 M = 0.2	16.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	4		
1418758-2	B																	
1418758-1	A																	
2141864-3	A	0.13 - 0.22	0.85 - 1.2	Cu Ni Si	Cu Sn 0.15/0.2	TIN PLATED verzinkt	1	A = 2.5 B = 1.7 C = 5.4	E = 1.5 G = 1.4	H = 2.0 K = 1.9 D <sub>150</sub> = 1.1	15.3	C10	4	TIN PLATED verzinkt	3	1		
2141864-2	A																	
2141864-1	A																	



- 1 LASER WELDED Lasergeschweisst
- 2 REVISION STATUS Revisionsstand
- 3 CONTACT AREA TAB MIN. 0.8µm SELECTIV GOLD OVER Ni Kontaktzone selectiv vergoldet min. 0.8µm ueber Ni
- 4 CONTACT AREA TAB MIN. 2.0µm SELECTIV SILVER Kontaktzone selectiv versilbert min. 2.0µm
- 5 DIFFERENT FORM OF THE SERRATIONS AND WIRE-CRIMP POSSIBLE unterschiedliche Ausfuhrung der Ritzen und des Draht-Crimps moeglich
- 6 RELEASED WIRE, SEE APPLICATION SPEC. TE 114-18464 Freigegebene Leitung, siehe

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP 1.12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP 1.12	TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	OWN R. Meier	DATE 30JUL03
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		CHK U. Muenk	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD	NAME
PLC ±	±		PRODUCT SPEC
PLC ±	±		108-18782
PLC ±	±		APPLICATION SPEC
PLC ±	±		114-18464
ANGLES ± °		WEIGHT	RESTRICTED TO
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle	Customer Drawing	A1 00779 ©= 1418754
		SCALE 10:1	SHEET 1 of 1
		REV C10	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9